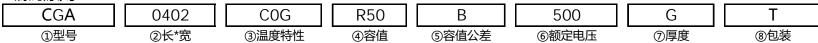
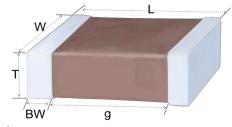
■范围

本产品规范适用于多层片式陶瓷电容器

■编码原则



■尺寸规格







■尺寸: (mm)

| ②长 | ②宽 | ⑦厚 | BW | g |
|----------------|-----------------|-----------------|-----------|-----|
| 1.0+0.10/-0.10 | 0.50+0.10/-0.10 | 0.50+0.10/-0.10 | 0.15-0.35 | 0.4 |

■额定值

| ③温度物 | 寺性 | ○交店 | 。宓估八关 | 。 | |
|---------------|-----------|---------------|--------|---------------|--|
| 温度范围 | 容值变化率 | ④容值 | ⑤容值公差 | ⑥额定电压 | |
| -55℃ to +125℃ | ±30ppm/°C | 0.5p F | ±0.1pF | 50 Vdc | |

| 序号 | 名称 |
|----|---------|
| 1 | 介电陶瓷 |
| 2 | 内电极 (镍) |
| 3 | 外电极 (铜) |
| 4 | 镍层 |
| 5 | |

■包装

| · | 包装方式 | 包装数量(颗) |
|---|-------------|----------------|
| T | φ180mm 卷筒纸带 | 10 ,000 |

CGA0402C0GR50B500GT 1 2024/08/12

■ 规格和测试方法



| No | 测试项目 | 测试规格 | | 测试方法(参考标 | 法(参考标准:JIS C 5101, IEC60384) | | | | |
|----|--------------------------|-------------------|---------------------|----------------|------------------------------|-----------------|--------------|--|--|
| 1 | 外观Appearance | 无缺陷或异常。 目 | | 目视 (显微镜) 检查产品。 | | | | | |
| 2 | 尺寸Dimension | 符合规格。 | | 使用千分尺检查证 | 使用千分尺检查设备的物理尺寸规范。 | | | | |
| | | | | 材质 | 额定电压(RV) | | 测试电压 | | |
| | | | | | RV≤50V | | 300% RV | | |
| | | | | COG | 50V < RV≤25 | 0V | 200% RV | | |
| | | | | 200 | 250V < RV≤5 | V00 | 150% RV | | |
| | | | | | 500V < RV≤1 | V000 | 130% RV | | |
| 3 | 耐电压 Voltage proof | 承受住测试电压, | 无缺陷或异常。 | | RV≤50V | | 250% RV | | |
| | Voltage proof | | | X7R/X5R/X6S | 50V < RV≤25 | OV | 200% RV | | |
| | | | | X/K/X3K/X63 | 250V < RV≤6 | 30V | 150% RV | | |
| | | | | | 630V < RV≤1000V | | 120% RV | | |
| | | | 测试时间 | | | 1到5秒 | | | |
| | | | | | | | 最大50mA | | |
| | | | | 测试温度 2 | | 25℃ | 25℃ | | |
| | | i抗 【 COG (以较小值为准) | ≥ 10 GΩ 或RC≥ 500Ω·F | 测试点 | | 在终端之间 | | | |
| 4 | 绝缘阻抗 Insulation | | (以较小值为准) | 测试电压 | | IF≤500V: 额定电压 | | | |
| 4 | Resistance(I.R.) | | | 测以电压 | | IF > 500V: 500V | | | |
| | | X7R/X5R/X6S | 100.0 Mohm | 充电时间 1 | | 1分钟 | | | |
| | | ATIVASIVAOS | TOO.0 IVIOTIIII | 充电/放电电流 | | 最大50mA | | | |
| | | | | 测量温度 | | | 25℃ | | |
| 5 | 容值 Capacitance | 在规定公差内。 | | 材质 | 容值 | 频率 | 电压 | | |
| | | | | C0C | C≤1000pF | 1.0±0.1MHz | 0.5-5.0Vrms | | |
| | 品质因子/ | | | C0G | C>1000pF | 1.0±0.1KHz | 1.0±0.2Vrms | | |
| | 消散系数 Q or Dissipation | 10.0% | | V7D (VED (VCC | C > 10uF | 120Hz±24Hz | 0.5V±0.1Vrms | | |
| | Factor (D.F.) | | | X7R/X5R/X6S | C≤10uF | 1.0±0.1KHz | 1.0±0.2Vrms | | |

■ 规格和测试方法



| | 杉 | | 材质容值变化 | | 阶段的电容变化应在5分钟后。 | | |
|---|-----------------------------------|---|-----------------------|--------------------------|-----------------------------------|--|--|
| | | C0G | 在±30ppm/°C内变化 | 在每个步骤达到热平衡后,按下表所示步骤测量电容。 | | | |
| | ᄱᄼᆘ | Coo | TET 200 Philly Charge | 步骤 | 温度 | | |
| 7 | 温度特性 Temperature | X5R | ±15% | 1 | 参考温度: 25±2℃ | | |
| | Characteristics of Capacitance | ASK | 11370 | 2 | 最低操作温度: ±3℃ | | |
| | | X6S | ±22% | 3 | 参考温度: 25±2℃ | | |
| | | | | 4 | 最高操作温度: ±2℃ | | |
| | X7R | | ±15% | 5 | 参考温度: 25±2℃ | | |
| | | | | 安装方法 | 将电容器焊接在测试基板上 | | |
| | | | | 作用力 | 5N (0402:2.5N / 0201:1N) | | |
| | 推力测试 | | | 作用时间 | 10±1秒 | | |
| 8 | Adhesive Strength | | | | 在试件中心沿P.C.板水平方向逐渐施加推力。 | | |
| | of Termination | | | 应用方向 | Pushing force Capacitor P.C.Board | | |
| | | 外观:无缺陷或异 | | 安装方法 | 在P.C.板上回流焊电容,并将其弯曲1mm。 | | |
| | 似鸟测瓜 Substrate Bending test | ΔC/C <通用系列> X7R/X5R: ± 10% C0G:± 1% 或 0.5 pF <高容系列> (取较大值) X7R/X5R: ± 12.5% | | | Q4.5 以1.0mm/s速度向下施加力 可由组成 | | |



| | | | | | 焊料:Sn-3.0Ag-0.5Cu(无铅焊料) | | | |
|----|----------------------|---------------|-----------------|------------------------------|--|--------------------------------------|---------------|--|
| | | | | | 助焊剂 :lsopropyl alcohol Rosin 25% solid solution. | | | |
| 10 | 可焊性 Solderability | 95%的终端应均匀 | 7连续焊接。 | | 焊锡温度 :245±5° | °C | | |
| | Soluciusiity | | | | 停留时间 :2±0.5s. | | | |
| | | | | | 焊锡位置:直到两端 | 計都完全浸湿 | | |
| | | 外观 | 外观无裂纹 | • | 预处理 | 热处理:在150+0/-10°C下热处理 24±2小时,然后测量。 | 里1小时,然后在室温下静置 | |
| | | | 材质 | 容值变化 | 测试方法 | 焊锡浴法 | | |
| | 耐焊接热 | 容值 | C0G | 在±2.5%或±0.25pF 之内,以较大的为准。 | 焊料种类 | Sn-3.0Ag-0.5Cu(Lead Free So | lder) | |
| 11 | Resistance to | | X7R/X5R/ X6S | ±7.5% | 测试温度 | 260±5℃ | | |
| | Soldering Heat | 品质因于/ 消散系数 | 同初始值。 | | 测试时间 | 10±1s | | |
| | | 绝缘阻抗 | 同初始值。 | | 预热温度 | 110℃ to 140℃ | | |
| | | 耐电压 | 无缺陷或异常。 | | 预热时间 | 1分钟 | | |
| | | 则电压 | | | 后处理 | 非处理:在室温下静置24±2小时,然后测量。 | | |
| | | | 无缺陷或异常。 | | 安装方法 | 将电容器焊接在测试基板上 | | |
| | | 外观 | | | 预处理 | 热处理:在150+0/-10°C下热处理 24±2小时,然后测量。 | 型1小时,然后在室温下静置 | |
| | | | 材质 | 容值变化 | 温度循环 | | 5个周期 | |
| 40 | 温度循环 | 容值 | COG | V7D (VED. : 150/ | 步骤 | 温度 | 时间 | |
| 12 | Temperature Cycle | | X7R/X5R/ X6S | X7R/X5R:±15% | 1 | 最低温度.±3℃ | 30±3min | |
| | | 品质因子/ | 同初始值。 | • | 2 | 室温 | 2~5min | |
| | | 消散系数 | 即以以阻 | | 3 | 最高温度.±3℃ | 30±3min | |
| | | | 同初始值 | | 4 | 室温 | 2~5min | |
| | | 绝缘阻抗 同初始值。 | | 后处理 | 非处理:在室温下静置24±2小时, | 然后测量。 | | |



| | | 外观 | 无缺陷或异 | 常。 | 安装方法 | 在测试之前,在附录2所示的P.C.板上回流焊电容 |
|----|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------------|--------------------------|--|--|
| | | | | 容值变化 | 预处理 | 热处理:在150+0/-10°C下热处理1小时,然后在 室温下静置24±2小时,然后测量。 |
| | | 容值 | 材质 | X7R/X5R:±12.5% | 测试温度 | 40±2°C |
| | | | | X/K/X5K:±12.5% | 测试湿度 | 90%RH to 95%RH |
| | | | 容值 | 品质因子 | 测试时间 | 500±24小时 |
| 13 | 恒温恒湿 (负载) | 品质因子/ | C≥30pF | 350min | 测试电压 | 额定电压(不超过630V) |
| 15 | High Temperature High Humidity | 消散系数 (COG) | 10pF < C < 30pF | 275+5/2*C min | 充电/放电电流 | 最大50mA |
| | | | < 10pF | 200+10*C min | | |
| | | 品质因子/ 消散系数 (X7R/X5R/X6S) | | % 或 2 倍初始值 % 或 2 倍初始值 | 电压调节 "在测试温度和电压下X 将电容器置于环境条件下24±2小 | 时电容器进行电压处理1小时后",在测量前 时,使用此测量值作为初始值。 |
| | | | 500MΩ或R.C≥ 5s (以较小值为准) | | | |
| | | 外观 | 无缺陷或异常。 | | 安装方法 | 将电容器焊接在测试基板上 |
| | | 容值 | 潜 值 材质 | 容值变化 | 预处理 | 热处理:在150+0/-10℃下热处理1小时,然 后在室温下静置24±2小时,然后测量。 |
| | | | | X7R/X5R:±15% | 测试温度 | 最高工作温度 ±3℃ |
| | | | | | 测试时间 | 1000±12小时 |
| | | | 容值 | 品质因子 | 测试电压 (life) | 100% R.V. |
| | 耐久测试 | 品质因子/ | C≥30pF | 350min | 充电/放电电流 | 最大50mA |
| 14 | Life | 消散系数 (COG) | 10pF < C < 30pF | 275+5/2*C min | | |
| | | | < 10pF | 200+10*C min | | |
| | | 品质因子/ 消散系数 (X7R/X5R/X6S) | 系数 ≥ 25V: ≤ 5%或2倍初始值 | | 电压调节"在测试温度和电压下对电容器进行电压处理1小时后",在测量前将电容器置于环境条件下24±2小时,使用此测量值作为初始值。 | |
| | | 绝缘阻抗 | | 2或R.C≥ 50s 为准) | | |



产品包装

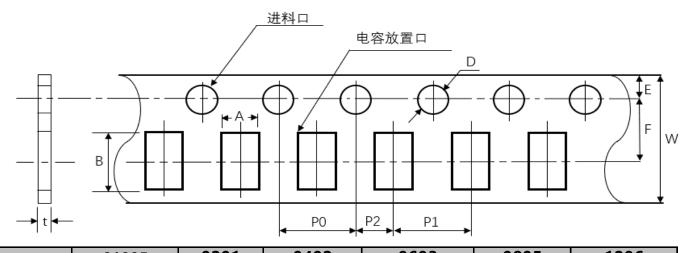
载带卷盘包装是目前最常见的包装方式,一个直径为180mm(7")的卷轴可包含1000~20000个电容,也可按照客户的要求进行卷盘包装

1. 包装数量

| | F | R寸 Size (mm |) | 编带规格 | | |
|-------|-----------------|-------------|---------|--------|-------------------|--|
| 规格 | 规格 长度 宽度 L W | | 厚度 T | 包装数量 | 包材 (默认卷盘7inch) | |
| 01005 | 0.40 | 0.20 | 0.20 | 20,000 | 纸带 | |
| 0201 | 0.60 | 0.30 | 0.30 | 15,000 | 纸带 | |
| 0402 | 1.00 | 0.50 | 0.50 | 10,000 | 纸带 | |
| 0603 | 1.60 | 0.80 | 0.80 | 4,000 | 纸带 | |
| | | | 0.60 | 4,000 | 纸带 | |
| 0805 | 2.00 | 1.25 | 0.85 | 4,000 | 纸带 | |
| | | | 1.25 | 2,000 | 塑胶带 | |
| | | | 0.85 | 4,000 | 纸带 | |
| 1206 | 3.20 | 1.60 | 1.25 | 2,000 | 塑胶带 | |
| | | | 1.60 | 2,000 | 塑胶带 | |
| | | | 1.25 | 3,000 | 塑胶带 | |
| 1210 | 3.20 | 2.50 | 1.60 | 2,000 | 塑胶带 | |
| 1210 | 3.20 | 2.30 | 2.00 | 1,000 | 塑胶带 | |
| | | | 2.50 | 1,000 | 塑胶带 | |



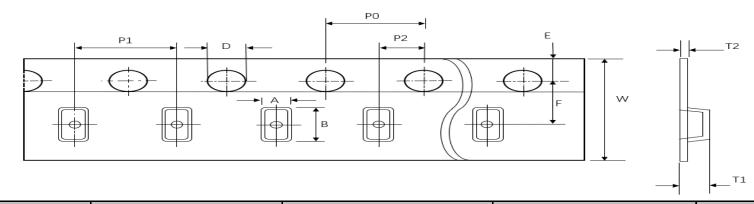
2. 纸带尺寸



| | 01005 | 0201 | 0402 | 0603 | 0805 | 1206 | |
|----|------------------|---------------------|-----------|---------------|-----------|-----------|--|
| | (0402) | (0603) | (1005) | (1608) | (2012) | (3216) | |
| P1 | 2.00 | ±0.05(1.0 ±0. | 05) | | 4.00±0.10 | | |
| P0 | | 4.00±0.10 | | | 4.00±0.10 | | |
| P2 | | 2.00±0.05 2.00±0.05 | | | | | |
| А | 0.25±0.02 | 0.38±0.03 | 0.62±0.05 | 1.00±0.01 | 1.55±0.10 | 2.05±0.10 | |
| В | 0.46±0.02 | 0.68±0.03 | 1.12±0.05 | 1.90±0.10 | 2.30±0.10 | 3.60±0.10 | |
| W | | 8.00±0.30 | | 8.00±0.30 | | | |
| E | | 1.75±0.10 | | 1.75±0.10 | | | |
| F | 3.50±0.05 | | | 3.50±0.05 | | | |
| D | φ1.50+0.10/-0.03 | | | φ1.50+0.10/-0 | | | |
| t | 0.25±0.02 | 0.35±0.03 | 0.60±0.05 | | 1.1Below | | |



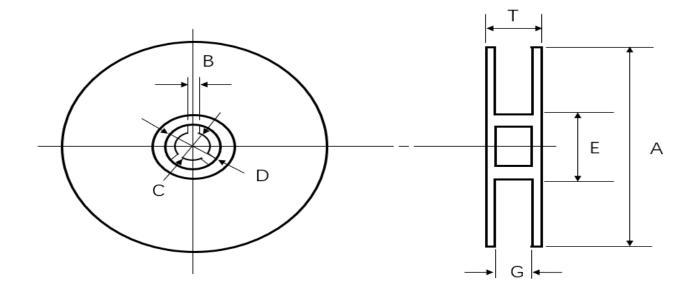
3. 塑料袋尺寸



| | 0603 (1608) | 0805 (2012) | 1206 (3216) | 1210 (3225) |
|----|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| P1 | 4±0.1 | 4±0.1 | 4±0.1 | 4±0.1 |
| P0 | 4±0.1 | 4±0.1 | 4±0.1 | 4±0.1 |
| P2 | 2±0.05 | 2±0.05 | 2±0.05 | 2±0.05 |
| А | 1.2±0.2 | 1.45±0.2 | 1.9±0.2 | 2.8±0.2 |
| В | 2.0±0.2 | 2.3±0.2 | 3.5±0.2 | 3.6±0.2 |
| W | 8±0.3 | 8±0.2 | 8±0.2 | 8±0.2 |
| E | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 | 1.75±0.1 |
| F | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 | 3.5±0.05 |
| D | 1.5 (+0.1/-0.0) | 1.5 (+0.1/-0.0) | 1.5 (+0.1/-0.0) | 1.5 (+0.1/-0.0) |
| T1 | 1.4 max | 2.5 max. | 2.5 max. | 2.5 max. |
| T2 | 0.25±0.1 | 0.305±0.1 | 0.30±0.1 | 0.30±0.1 |



4. 圆盘尺寸



| 圆盘尺寸 | A | B | C | D | E | G | T |
|--------|----------|---------|---------|---------|--------|--------|--------|
| | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) |
| 7"Reel | Ф178±2.0 | 2.0±0.5 | Ф13±1.0 | Ф21±0.8 | Φ50或更大 | 10±1.0 | 13±1.0 |



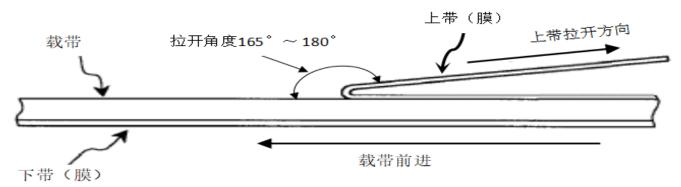
5. 包装方式和规格

一般情况下使用Φ180mm (7") 的料盘进行包装,每5盘封装为一盒,每12盒为一整箱。不足整盒的单独用一小盒包装。也可以按照客户的要求进行包装。

| 尺寸 | 载带 | 料盘尺寸 | 盘/盒 | 盒/箱 |
|-------|--------|------|-----|-----|
| 01005 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0201 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0402 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0603 | 纸带 | 7" | 5 | 12 |
| 0805 | 纸带/塑料袋 | 7" | 5 | 12 |
| 1206 | 纸带/塑料袋 | 7" | 5 | 12 |
| 1210 | 塑料袋 | 7" | 5 | 12 |

6. 卷装带使用说明

成品在使用时,上带(膜)以 300±10mm/min的速度,165°~180°的角度(如下图示),剥离强度在0.1N~0.7N(10g.f≤剥离力≤70g.f)。





应用限制

在使用我们的产品之前,请与我们联系以下所列的应用,特别要求高的可靠性,以防止可能直接对第三方的生命,身体或财产造成损害的 缺陷。

①飞机设备 ②航空航天设备 ③海底设备 ④电厂控制设备 ⑤医疗设备 ⑥交通设备(车辆、火车、船舶等) ⑦交通信号设备 ⑧防灾/预防犯罪设备 ⑨数据处理设备 ⑩复杂度和/或可靠性要求与上述应用类似的应用。

运输与储存方法

1. 运输:

包装的产品适应现代交通工具运输,在运输过程中要防止雨淋和酸碱腐蚀,不得重力抛掷和猛力挤压。

2. 储存:

确保产品可焊性良好的贮存期限为:自生产之日保存期为一年,产品使用之前请勿拆开编带(在包装好已交付的情况下),编带拆开后,产品应在三个月内使用。

储存温度: 0°C~35°C 储存相对湿度: <70%

使用注意事项

多层片式瓷介电容器(MLCC)在超出本承认书或相关说明书中所述使用频率的恶劣工作环境,或外界机械力超压作用下,电容有可能会出现 短路、开路,或者有可能会冒烟、燃烧甚至爆炸,所以在使用的时候,首先应考虑按本承认书的有关说明来进行,如有不明之处,请联系我们技术部、品管部或生产部。



1. 焊接时焊料的用量

A.焊料过多这样会因电容端头压力过大而可能引起电容受损。

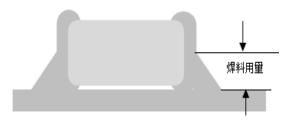


2.推荐焊料用量:

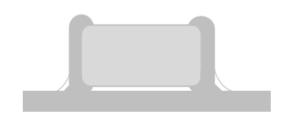
A.回流焊接的最佳焊料用量



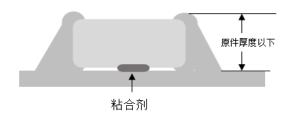
C.使用烙铁返修时的最佳焊料用量



B.焊料太少固定力量不足,可能会引起电容芯片与线路接触不良。



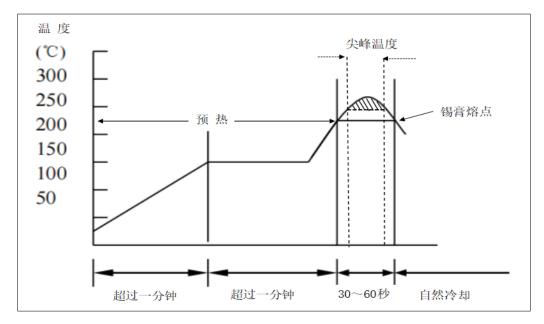
B.波峰焊接的最佳焊料用量





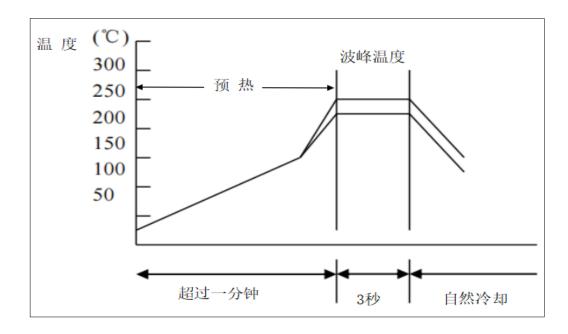
3.推荐焊接温度曲线图:

回流焊接



| 焊锡类型 | Pb-Sn焊接 | 无铅焊接 | | |
|------|-----------|-----------|--|--|
| 尖峰温度 | 230℃~250℃ | 240℃~260℃ | | |
| 尖峰时间 | 3s ~ 10s | 3s ~ 10s | | |

波峰焊接

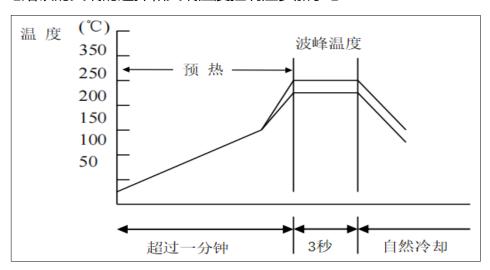


| 焊锡类型 | Pb-Sn焊接 | 无铅焊接 | | |
|------|-----------|-----------|--|--|
| 尖峰温度 | 230℃~260℃ | 240℃~270℃ | | |
| 尖峰时间 | 3s内 | 3s内 | | |



手工焊接

手工焊接很容易因为电容局部受热不均而引起瓷体微裂或局部爆裂现象。因此,使用电烙铁手工焊接时应仔细操作,并对电烙铁的尖端的选择和尖端温度控制应多加小心.



| 预热 | 烙铁头温度 | 烙铁功率 | 烙铁头直径 | 焊接时间 | 锡膏量 | 注意事项 |
|---------|--------|------|-------|------|----------|--------------|
| △≤130°C | ≤350°C | ≤20W | 建议1mm | ≤3s | ≤1/2电容高度 | 烙铁头勿直接接触陶瓷本体 |

X-ON Electronics

Largest Supplier of Electrical and Electronic Components

Click to view similar products for Multilayer Ceramic Capacitors MLCC - SMD/SMT category:

Click to view products by HRE manufacturer:

Other Similar products are found below:

M39014/02-1225V M39014/22-0631 C1608C0G2A221J C1608X7R1E334K C2012C0G2A472J C1005X5R0G225M 726632-1

CDR35BX104BKUR\M500 M39014/220214 CHP1-100-8202-G-LF674A 1206B103K501NT 0402N820J101CT 1206N221J202CT 1206N220J501CT 0603X155K6R3CT 1206N3R9C102CT 1206N151J500CT 1206N103J101CT 0603B152K201CT RF18N5R0B500CT 0603B472K201CT 0603N1R0C251CT 0805B153K201CT 1210B333K101CT CC0100JRNPO8BN100 CC0100JRNPO6BN101 CC0805KRX7R0BB821 CC0402JRNPO9BN301 CC0100JRNPO7BN100 CC0805KKX7R0BB105 AC0805KKX7R6BB475 CC0805FRNPO9BN750 CC0805KKX7R7BB824 CC0805KRX7RBBB561 CQ0402DRNPO9BN5R6 AF0100FR-07200KL CC0201FRNPO9BN200 CC0805CRNPO0BN5R0 CC0805GKNPO9BN472 CC1206JKX7R9BB474 CC0805GRNPO0BN391 CC1206JRX7R8BB474 CC0201CRNPO8BN8R0 CC0201BRNPO8BNR70 CC0201JRX7R7BB332 CC0805GRNPO9BN201 CC0100KRX5R6BB103 CC0402GRNPO9BN102 CC1206ZRY5V6BB105 CC0805KRNPO9BN180